



芯智双驱：2026 年政府工作报告集 集成电路与 AI 产业布局政策解读

联合资信 工商评级一部 崔濛骁 宁立杰

2026 年《政府工作报告》明确集成电路与人工智能为新质生产力核心支撑，形成“芯为底座、智为引擎”双轮驱动格局。集成电路作为新兴支柱产业首位，聚焦全链条攻关核心环节，获得资金政策双重保障；人工智能定位智能经济核心引擎，深化多领域应用、升级基础设施并完善治理。二者协同赋能，构建硬件与软件双向支撑的良性循环，推动产业国产替代与生态繁荣。政策推动下，集成电路与人工智能将实现规模与质量双提升，助力科技自立自强与经济高质量发展。从信用角度看，政策导向将加剧行业内部信用水平分化，深耕核心环节、技术壁垒高、符合战略方向的头部企业，将获得更多资源倾斜，信用水平持续提升；而缺乏核心技术、依赖外部供给、同质化竞争的企业，信用支撑趋弱。



联合资信评估股份有限公司
China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.

一、战略定位：芯为底座、智为引擎，双轮支撑新质生产力

2026年《政府工作报告》（以下简称“《报告》”）提到“培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。”“打造智能经济新形态。深化拓展“人工智能+，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。”《报告》将集成电路列为新兴支柱产业首位，定位为数字经济与高端制造“算力底座”；将人工智能提升至智能经济新形态高度，以“人工智能+”推动全行业融合。两大领域从孤立赛道，升级为底层硬件—智能算法—场景应用闭环体系，共同承担产业链安全保障、增长新动能培育双重使命。

集成电路：数字经济与高端制造的“算力底座”。《报告》将集成电路列为新兴支柱产业首位，凸显其作为产业安全、技术自主核心的战略优先级，明确其为新质生产力的“现实增长极”。区别于以往的产业扶持，此次将其提升至支柱层级，要求全链条突破“卡脖子”环节，支撑高端制造、人工智能、新能源等领域的自主发展。

人工智能：智能经济新形态的“核心引擎”。首次明确提出打造智能经济新形态，以“人工智能+”为核心抓手，推动AI从技术应用向产业生态、原生业态升级。AI不仅是赋能工具，更成为培育新业态、新模式的核心动力，与集成电路形成“硬件底座+软件智能”的双轮驱动格局。

二、芯智融合：支柱化与国产化提速，构建自主可控产业生态

以“双轮驱动”培育新质生产力，一方面通过集成电路筑牢产业硬件基础，另一方面借助人工智能激活数据要素潜能，二者协同发力，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。从双向赋能来看，集成电路为人工智能提供算力支撑和算法落地的硬件保障，人工智能则为集成电路产业的设计优化、智能制造、需求迭代提供软件赋能，形成“芯片性能提升—AI应用升级—芯片需求扩大”的良性循环。从产业衔接来看，集成电路作为新兴支柱产业，为量子科技、具身智能、脑机接口等未来产业提供基础算力和硬件载体；人工智能技术则提前布局未来产业的应用场景，实现“稳固现有支柱产业、抢占未来产业赛道”的战略衔接。

集成电路通过全链条攻关与资金保障筑牢产业根基。技术攻关聚焦核心环节，重点突破高端芯片设计、先进制程（7nm及以下）、EDA工具、光刻机核心零部件、封测技术等关键领域，推动成熟制程扩产与国产替代，目标提升核心芯片自给率至50%以上（2030年）。**资金与政策双重支撑**，超长期特别国债、地方专项债、中央预算内投资优先投向集成电路全产业链项目，符合条件的项目可获最高60%投资补助；

“十五五”研发经费年均增长 7%以上，强化基础研究与产业化衔接。**生态构建强化协同**，鼓励中央企业、国有企业开放自身应用场景，推动汽车电子、工业控制、AI 芯片等领域的供需精准对接，打造集设计、制造、封测、设备材料于一体的产业集群，提升产业整体竞争力。

人工智能依托场景落地与生态繁荣，培育智能原生生态。深化“人工智能+”应用，推动人工智能在工业、农业、政务服务、医疗健康、交通运输等重点领域实现商业化、规模化应用，加快新一代智能终端和智能体的推广普及，培育智能服务、智能制造、智能运营等智能原生新业态。**基础设施升级**，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展，夯实 AI 算力基础；同时加快卫星互联网、“5G+工业互联网”升级版建设，拓展 AI 应用边界。**生态与治理并重**，支持 AI 开源社区建设，繁荣开源生态；完善人工智能治理体系，平衡技术创新与风险防控，保障产业健康发展。

三、政策影响

产业层面，集成电路将加速国产替代进程，成熟制程产能释放、先进制程攻关提速，设备材料国产化率提升，产业规模持续扩大，有望成为全球第三大芯片制造基地。AI 将从单点应用向全行业深度渗透，智能体、开源生态、算电协同成为产业增长点，智能经济新形态将推动数字经济与实体经济深度融合。

企业层面，集成电路企业将获资金、场景、政策三重支持，重点布局芯片设计、制造、封测及设备材料的企业将优先受益。人工智能企业聚焦行业解决方案、智能终端、开源生态建设，可依托政策红利拓展市场，推动技术成果实现商业化落地。

区域与国家层面，各地可依托产业基础布局集成电路产业园、智算中心，形成区域特色产业集群；国家层面通过芯智双驱，提升科技自立自强能力，支撑经济高质量发展。

四、总结

2026 年《政府工作报告》明确集成电路与人工智能为新质生产力核心支撑，形成“芯为底座、智为引擎”双轮驱动格局。集成电路作为新兴支柱产业首位，聚焦全链条攻关核心环节，获得资金政策双重保障；人工智能定位智能经济核心引擎，深化多领域应用、升级基础设施并完善治理。二者协同赋能，构建硬件与软件双向支撑的良性循环，推动产业国产替代与生态繁荣。政策推动下，集成电路与人工智能将实现规模与质量双提升，助力科技自立自强与经济高质量发展。从信用角度看，政策导向将加剧行业内部信用水平分化，深耕核心环节、技术壁垒高、符合战略方向的头部企业，将获得更多资源倾斜，信用水平持续提升；而缺乏核心技术、依赖外部供给、同

质化竞争的企业，信用支撑趋弱。

联系人

投资人服务 010-85172818-8088investorservice@lhratings.com

免责声明

本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。

本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。

在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。